

電子回路基板生産動向(2006年)

	当月実績		前年同月比		累 計		前年同期間比		
	数量 (千㎡)	生産額 (百万円)	数量 (%)	生産額 (%)	数量 (千㎡)	生産額 (百万円)	数量 (%)	生産額 (%)	
平成 18年 1月 実績	電子回路基板	1,959	70,714	98.3	113.2	1,959	70,714	98.3	113.2
	リジッドプリント配線板	1,297	43,852	98.5	115.3	1,297	43,852	98.5	115.3
	片面プリント配線板	238	1,189	77.5	77.1	238	1,189	77.5	77.1
	両面プリント配線板	566	10,995	101.3	105.1	566	10,995	101.3	105.1
	多層プリント配線板(4層)	267	8,931	109.0	112.0	267	8,931	109.0	112.0
	多層プリント配線板(6-8層)	105	9,303	111.7	124.4	105	9,303	111.7	124.4
	多層プリント配線板(10層以上)	24	4,164	114.3	130.9	24	4,164	114.3	130.9
	ビルドアップ多層配線板	96	9,270	105.5	125.2	96	9,270	105.5	125.2
	フレキシブルプリント配線板	406	10,635	85.8	92.4	406	10,635	85.8	92.4
	片面フレキシブル配線板	196	4,430	74.5	86.7	196	4,430	74.5	86.7
	両面・多層フレキシブル配線板	210	6,205	100.5	97.0	210	6,205	100.5	97.0
	モジュール基板	254	16,078	127.0	126.3	254	16,078	127.0	126.3
	リジッド系モジュール基板	37	8,366	112.1	129.0	37	8,366	112.1	129.0
その他のモジュール基板	217	7,712	129.2	123.4	217	7,712	129.2	123.4	
その他の電子回路基板	2	149	100.0	88.2	2	149	100.0	88.2	
平成 18年 2月 実績	電子回路基板	2,046	73,509	102.2	116.2	4,005	144,223	100.3	114.7
	リジッドプリント配線板	1,376	47,303	103.0	119.7	2,673	91,155	100.8	117.5
	片面プリント配線板	262	1,198	84.8	77.6	500	2,387	81.2	77.3
	両面プリント配線板	590	12,029	104.2	113.9	1,156	23,024	102.8	109.5
	多層プリント配線板(4層)	277	9,462	114.0	116.5	544	18,393	111.5	114.3
	多層プリント配線板(6-8層)	114	9,786	114.0	122.1	219	19,089	112.9	123.2
	多層プリント配線板(10層以上)	29	4,583	145.0	144.5	53	8,747	129.3	137.7
	ビルドアップ多層配線板	104	10,245	106.1	126.5	200	19,515	105.8	125.9
	フレキシブルプリント配線板	430	11,073	90.5	95.7	836	21,708	88.3	94.1
	片面フレキシブル配線板	206	4,495	79.5	90.1	402	8,925	77.0	88.4
	両面・多層フレキシブル配線板	224	6,578	103.7	99.9	434	12,783	102.1	98.4
	モジュール基板	238	14,939	125.9	124.5	492	31,017	126.2	125.4
	リジッド系モジュール基板	34	7,649	109.7	125.2	71	16,015	110.9	127.2
その他のモジュール基板	203	7,290	128.5	123.7	420	15,002	128.8	123.5	
その他の電子回路基板	2	194	100.0	112.8	4	343	100.0	100.6	
平成 18年 3月 実績	電子回路基板	2,193	81,008	101.2	115.0	6,198	225,231	100.6	114.8
	リジッドプリント配線板	1,467	51,380	102.8	116.2	4,140	142,535	101.5	117.1
	片面プリント配線板	283	1,260	91.6	76.0	783	3,647	84.6	76.9
	両面プリント配線板	620	12,633	104.2	113.4	1,776	35,657	103.3	110.9
	多層プリント配線板(4層)	307	10,404	112.5	112.4	851	28,797	111.8	113.6
	多層プリント配線板(6-8層)	118	10,799	99.2	112.3	337	29,888	107.7	119.0
	多層プリント配線板(10層以上)	30	5,203	130.4	142.5	83	13,950	129.7	139.4
	ビルドアップ多層配線板	110	11,081	102.8	124.6	310	30,596	104.7	125.4
	フレキシブルプリント配線板	470	12,194	91.4	96.3	1,306	33,902	89.4	94.8
	片面フレキシブル配線板	227	5,110	83.2	95.7	629	14,035	79.1	90.9
	両面・多層フレキシブル配線板	243	7,084	100.8	96.7	677	19,867	101.7	97.8
	モジュール基板	253	17,222	112.9	128.7	745	48,239	121.5	126.6
	リジッド系モジュール基板	41	9,676	124.2	146.7	112	25,691	115.5	133.9
その他のモジュール基板	212	7,546	110.4	111.2	632	22,548	122.2	119.1	
その他の電子回路基板	2	212	66.7	101.9	6	555	85.7	101.1	
平成 18年 4月 実績	電子回路基板	1,995	74,260	98.8	113.5	8,193	299,491	100.1	114.5
	リジッドプリント配線板	1,351	47,600	99.3	116.5	5,491	190,135	101.0	116.9
	片面プリント配線板	256	1,173	83.4	72.7	1,039	4,820	84.3	75.8
	両面プリント配線板	577	11,860	101.1	110.2	2,353	47,517	102.7	110.7
	多層プリント配線板(4層)	272	9,300	109.2	107.7	1,123	38,097	111.2	112.1
	多層プリント配線板(6-8層)	117	10,108	109.3	123.8	454	39,996	108.1	120.2
	多層プリント配線板(10層以上)	32	5,051	152.4	139.8	115	19,001	135.3	139.5
	ビルドアップ多層配線板	98	10,108	94.2	125.4	408	40,704	102.0	125.4
	フレキシブルプリント配線板	423	10,924	95.7	95.4	1,729	44,826	90.9	95.0
	片面フレキシブル配線板	191	4,255	82.0	88.8	820	18,290	79.8	90.4
	両面・多層フレキシブル配線板	232	6,669	111.0	100.2	909	26,536	103.9	98.4
	モジュール基板	219	15,558	102.3	120.6	964	63,797	116.4	125.0
	リジッド系モジュール基板	36	9,234	116.1	148.7	148	34,925	115.6	137.5
その他のモジュール基板	183	6,324	100.0	94.5	815	28,872	116.4	112.7	
その他の電子回路基板	2	178	66.7	79.1	8	733	80.0	94.7	

電子回路基板生産動向(2006年)

	当月実績		前年同月比		累 計		前年同期比		
	数量 (千㎡)	生産額 (百万円)	数量 (%)	生産額 (%)	数量 (千㎡)	生産額 (百万円)	数量 (%)	生産額 (%)	
平成 18年 5月 実績	電子回路基板	1,994	74,375	104.9	118.4	10,187	373,866	101.0	115.2
	リジッドプリント配線板	1,362	47,817	107.0	120.6	6,853	237,952	102.1	117.6
	片面プリント配線板	261	1,195	90.3	81.0	1,300	6,015	85.4	76.8
	両面プリント配線板	579	12,045	111.1	122.5	2,932	59,562	104.3	112.9
	多層プリント配線板(4層)	273	9,481	115.7	110.4	1,396	47,578	112.0	111.8
	多層プリント配線板(6-8層)	115	10,228	106.5	117.0	569	50,224	107.8	119.5
	多層プリント配線板(10層以上)	29	4,827	145.0	141.3	144	23,828	137.1	139.9
	ビルドアップ多層配線板	105	10,041	106.1	132.0	513	50,745	102.8	126.7
	フレキシブルプリント配線板	407	10,772	98.5	104.8	2,136	55,598	92.2	96.7
	片面フレキシブル配線板	181	4,116	80.4	97.7	1,001	22,406	79.9	91.7
	両面・多層フレキシブル配線板	226	6,656	120.2	109.7	1,135	33,192	106.8	100.5
	モジュール基板	223	15,613	104.7	122.8	1,187	79,410	114.0	124.6
	リジッド系モジュール基板	36	9,095	112.5	144.3	184	44,020	115.0	138.9
その他のモジュール基板	187	6,518	103.3	101.6	1,002	35,390	113.7	110.5	
その他の電子回路基板	2	173	100.0	104.2	10	906	83.3	96.4	
平成 18年 6月 実績	電子回路基板	2,164	81,724	104.3	117.5	12,351	455,590	101.6	115.6
	リジッドプリント配線板	1,463	52,288	106.0	117.9	8,316	290,240	102.8	117.7
	片面プリント配線板	278	1,314	90.8	89.3	1,578	7,329	86.3	78.8
	両面プリント配線板	612	12,634	107.2	114.0	3,544	72,196	104.8	113.1
	多層プリント配線板(4層)	301	10,330	115.8	111.9	1,697	57,908	112.6	111.8
	多層プリント配線板(6-8層)	125	11,193	106.8	117.4	694	61,417	107.8	119.1
	多層プリント配線板(10層以上)	35	5,682	145.8	143.6	179	29,510	137.7	140.6
	ビルドアップ多層配線板	111	11,135	108.8	123.1	624	61,880	103.8	126.0
	フレキシブルプリント配線板	470	12,218	104.7	109.7	2,606	67,816	94.2	98.8
	片面フレキシブル配線板	192	4,627	76.2	97.6	1,193	27,033	79.2	92.7
	両面・多層フレキシブル配線板	279	7,591	142.3	118.6	1,414	40,783	112.3	103.4
	モジュール基板	228	17,052	93.4	122.5	1,415	96,462	110.1	124.2
	リジッド系モジュール基板	45	10,241	136.4	157.5	229	54,261	118.7	142.0
その他のモジュール基板	183	6,811	86.3	91.8	1,185	42,201	108.4	106.9	
その他の電子回路基板	2	166	100.0	110.7	12	1,072	85.7	98.3	
平成 18年 7月 実績	電子回路基板	2,081	80,223	99.7	115.6	14,432	535,813	101.3	115.6
	リジッドプリント配線板	1,406	51,119	102.0	116.1	9,722	341,359	102.7	117.4
	片面プリント配線板	259	1,256	91.5	92.7	1,837	8,585	87.0	80.5
	両面プリント配線板	596	12,075	102.4	107.2	4,140	84,271	104.4	112.2
	多層プリント配線板(4層)	286	9,482	105.9	101.7	1,983	67,390	111.6	110.2
	多層プリント配線板(6-8層)	118	10,985	104.4	121.2	812	72,402	107.3	119.4
	多層プリント配線板(10層以上)	35	5,394	152.2	142.7	214	34,904	139.9	140.9
	ビルドアップ多層配線板	112	11,927	104.7	128.9	736	73,807	104.0	126.5
	フレキシブルプリント配線板	451	11,844	99.6	106.1	3,057	79,660	95.0	99.9
	片面フレキシブル配線板	183	4,434	76.6	99.2	1,376	31,467	78.9	93.5
	両面・多層フレキシブル配線板	268	7,410	125.8	110.8	1,682	48,193	114.3	104.5
	モジュール基板	222	17,071	87.4	121.4	1,637	113,533	106.3	123.8
	リジッド系モジュール基板	47	10,784	151.6	166.8	276	65,045	123.2	145.6
その他のモジュール基板	175	6,287	78.5	82.8	1,360	48,488	103.3	103.1	
その他の電子回路基板	3	189	150.0	125.2	15	1,261	93.8	101.6	
平成 18年 8月 実績	電子回路基板	2,013	81,897	97.9	118.3	16,445	617,710	100.9	116.0
	リジッドプリント配線板	1,347	51,473	100.1	118.1	11,069	392,832	102.3	117.5
	片面プリント配線板	246	1,169	94.3	93.9	2,083	9,754	87.8	81.9
	両面プリント配線板	575	11,555	99.0	103.5	4,715	95,826	103.7	111.1
	多層プリント配線板(4層)	278	10,448	106.1	113.4	2,261	77,838	110.9	110.7
	多層プリント配線板(6-8層)	109	11,758	101.9	133.5	921	84,160	106.6	121.2
	多層プリント配線板(10層以上)	30	5,042	142.9	138.2	244	39,946	140.2	140.6
	ビルドアップ多層配線板	111	11,501	97.4	121.1	847	85,308	103.0	125.7
	フレキシブルプリント配線板	427	11,209	96.0	104.7	3,484	90,869	95.1	100.4
	片面フレキシブル配線板	172	4,105	73.5	85.3	1,548	35,572	78.2	92.5
	両面・多層フレキシブル配線板	255	7,104	120.9	120.6	1,937	55,297	115.1	106.3
	モジュール基板	236	19,051	89.4	128.9	1,873	132,584	103.8	124.5
	リジッド系モジュール基板	49	12,267	148.5	175.0	325	77,312	126.5	149.6
その他のモジュール基板	187	6,784	81.0	87.4	1,547	55,272	100.0	100.8	
その他の電子回路基板	2	164	100.0	105.8	17	1,425	94.4	102.1	

電子回路基板生産動向(2006年)

	当月実績		前年同月比		累 計		前年同期比		
	数量 (千㎡)	生産額 (百万円)	数量 (%)	生産額 (%)	数量 (千㎡)	生産額 (百万円)	数量 (%)	生産額 (%)	
平成 18年 9月 実績	電子回路基板	2,151	85,010	98.3	114.4	18,596	702,720	100.6	115.8
	リジッドプリント配線板	1,420	53,544	99.0	113.9	12,489	446,376	101.9	117.1
	片面プリント配線板	250	1,241	92.6	96.8	2,333	10,995	88.3	83.4
	両面プリント配線板	618	12,862	98.4	105.6	5,333	108,688	103.1	110.4
	多層プリント配線板(4層)	285	10,357	105.9	109.5	2,546	88,195	110.3	110.5
	多層プリント配線板(6-8層)	119	11,772	104.4	125.3	1,040	95,932	106.3	121.7
	多層プリント配線板(10層以上)	31	5,191	129.2	137.9	275	45,137	138.9	140.2
	ビルドアップ多層配線板	117	12,121	90.7	111.0	964	97,429	101.4	123.7
	フレキシブルプリント配線板	464	12,049	96.5	102.8	3,948	102,918	95.3	100.7
	片面フレキシブル配線板	187	4,456	75.4	86.0	1,735	40,028	77.9	91.7
	両面・多層フレキシブル配線板	277	7,593	118.9	116.2	2,214	62,890	115.6	107.4
	モジュール基板	266	19,249	98.5	125.4	2,139	151,833	103.2	124.6
	リジッド系モジュール基板	44	11,625	133.3	162.3	369	88,937	127.2	151.2
その他のモジュール基板	221	7,624	93.2	93.1	1,768	62,896	99.2	99.8	
その他の電子回路基板	2	168	50.0	63.9	19	1,593	86.4	96.0	
平成 18年 10月 実績	電子回路基板	2,190	88,287	100.6	119.1	20,786	791,007	100.6	116.1
	リジッドプリント配線板	1,457	55,763	101.0	119.9	13,946	502,139	101.8	117.4
	片面プリント配線板	268	1,224	94.0	92.8	2,601	12,219	88.9	84.2
	両面プリント配線板	632	13,185	101.3	114.0	5,965	121,873	102.9	110.8
	多層プリント配線板(4層)	290	11,128	111.5	117.8	2,836	99,323	110.4	111.3
	多層プリント配線板(6-8層)	118	12,362	99.2	128.9	1,158	108,294	105.6	122.5
	多層プリント配線板(10層以上)	28	5,205	127.3	138.9	303	50,342	137.7	140.1
	ビルドアップ多層配線板	121	12,659	91.0	116.6	1,085	110,088	100.1	122.8
	フレキシブルプリント配線板	457	12,080	101.8	105.3	4,405	114,998	95.9	101.2
	片面フレキシブル配線板	190	4,550	86.4	95.3	1,925	44,578	78.6	92.1
	両面・多層フレキシブル配線板	267	7,530	116.1	112.3	2,481	70,420	115.7	107.9
	モジュール基板	273	20,297	97.2	128.0	2,412	172,130	102.5	125.0
	リジッド系モジュール基板	53	12,712	160.6	180.7	422	101,649	130.7	154.3
その他のモジュール基板	220	7,585	88.7	86.0	1,988	70,481	97.9	98.1	
その他の電子回路基板	2	147	50.0	55.3	21	1,740	80.8	90.4	
平成 18年 11月 実績	電子回路基板	2,137	87,811	95.4	112.4	22,923	878,818	100.0	115.8
	リジッドプリント配線板	1,408	54,759	94.2	110.5	15,354	556,898	101.1	116.7
	片面プリント配線板	260	1,213	84.1	86.5	2,861	13,432	88.4	84.4
	両面プリント配線板	606	12,423	95.3	103.7	6,571	134,296	102.1	110.1
	多層プリント配線板(4層)	277	10,808	103.7	107.8	3,113	110,131	109.8	110.9
	多層プリント配線板(6-8層)	121	12,918	96.8	121.3	1,279	121,212	104.7	122.4
	多層プリント配線板(10層以上)	30	5,241	125.0	125.1	333	55,583	136.5	138.5
	ビルドアップ多層配線板	113	12,156	83.7	107.4	1,198	122,244	98.3	121.1
	フレキシブルプリント配線板	451	11,530	99.1	100.8	4,856	126,528	96.2	101.1
	片面フレキシブル配線板	193	4,688	90.2	97.3	2,118	49,266	79.6	92.5
	両面・多層フレキシブル配線板	258	6,842	106.6	103.4	2,739	77,262	114.7	107.5
	モジュール基板	276	21,379	95.8	126.6	2,688	193,509	101.7	125.2
	リジッド系モジュール基板	54	13,494	142.1	167.7	476	115,143	131.9	155.8
その他のモジュール基板	222	7,885	88.8	89.2	2,210	78,366	96.9	97.1	
その他の電子回路基板	2	143	66.7	64.4	23	1,883	79.3	87.7	
平成 18年 12月 実績	電子回路基板	2,010	83,860	99.1	112.9	24,933	962,678	100.0	115.5
	リジッドプリント配線板	1,307	51,450	97.8	110.5	16,661	608,348	100.8	116.1
	片面プリント配線板	236	1,170	94.0	92.6	3,097	14,602	88.8	85.0
	両面プリント配線板	578	11,644	101.0	102.8	7,149	145,940	102.0	109.5
	多層プリント配線板(4層)	256	10,216	97.3	107.8	3,368	120,347	108.7	110.7
	多層プリント配線板(6-8層)	112	12,760	100.9	129.5	1,389	133,972	104.2	123.0
	多層プリント配線板(10層以上)	29	5,029	126.1	119.5	362	60,612	135.6	136.7
	ビルドアップ多層配線板	96	10,631	82.1	101.8	1,295	132,875	97.0	119.3
	フレキシブルプリント配線板	416	10,766	98.6	97.9	5,270	137,294	96.3	100.9
	片面フレキシブル配線板	178	4,427	82.4	89.9	2,295	53,693	79.8	92.3
	両面・多層フレキシブル配線板	238	6,339	116.1	104.4	2,975	83,601	114.8	107.3
	モジュール基板	284	21,474	106.0	129.8	2,973	214,983	102.2	125.6
	リジッド系モジュール基板	52	13,516	140.5	168.5	530	128,659	133.2	157.0
その他のモジュール基板	232	7,958	100.9	93.3	2,443	86,324	97.3	96.8	
その他の電子回路基板	3	170	150.0	106.3	28	2,053	93.3	89.0	

(出所：経済産業省「機械統計月報」)

(2007/6/8 発表 / 2007/6/13 JPCA作成)